

## 7月国内手机出货量同比下降7.5%

——电子行业周观点 (08.12-08.18)

同步大市 (维持)

日期: 2019年08月19日

### 行业核心观点:

上周电子指数上涨7.97%，跑赢沪深300指数5.85个百分点，各级子行业全部上涨。5G牌照发放后，5G终端开始陆续发布，以华为手机、华为鸿蒙系统为代表，国内厂商在5G终端的竞争优势将大大优于4G时期，建议关注5G产业链。半导体方面，全球销售额继续下滑，上半年同比下降14.5%，其中6月份同比下降16.8%，降幅较大，继续关注反转信号，建议关注细分板块龙头的国产替代机会。另外，现在已进入业绩公告期，建议关注业绩超预期个股。

### 投资要点:

- **7月国内手机同比下降7.5%，5G手机人气旺**

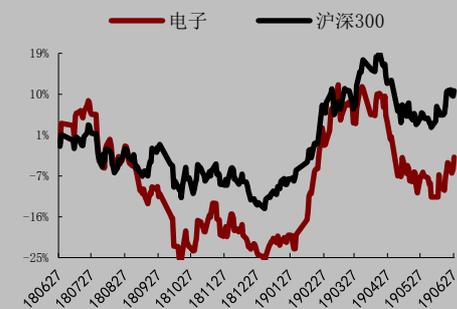
根据中国信通院数据，2019年7月我国国内手机市场总体出货量3419.9万部，同比下降7.5%。2019年1-7月，国内手机市场总体出货量2.20亿部，同比下降5.5%。整体手机销售仍处于下滑周期，但是5G手机销售火热。华为Mate 20X 5G版预约量全平台突破百万台，8月16日开始销售，销售首日在天猫仅1秒即被一抢而空，可见5G手机市场需求旺盛，随着更多5G机型上市及价格下滑，预计手机销量有望止跌回升。

- **2019Q2全球手机市场中国品牌市占率42%**

根据IHS Markit的数据，2019年第二季度中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，展现出强劲竞争力。其中华为手机全球市占率18%，排名第二；OPPO手机销量3620万部，超过苹果全球排名第三。中国手机全球竞争力逐渐加强，我们认为国内厂商在5G终端的竞争优势将大大优于4G时期，建议关注华为5G产业链。

- **风险因素:** 行业景气度不及预期的风险；国内外政策变动风险

### 电子行业相对沪深300指数表



数据来源: WIND, 万联证券研究所

数据截止日期: 2019年08月16日

### 相关研究

万联证券研究所 20190812\_行业周观点\_AAA\_电子行业周观点 (08.05-08.11)\_华为鸿蒙系统发布, 关注国产替代

万联证券研究所 20190812\_公司半年报点评\_AAA\_深南电路 (002916) 2019年中报点评\_5G收入占比提升, 持续受益5G建设

万联证券研究所 20190805\_行业周观点\_AAA\_电子行业周观点 (07.29-08.04)\_不确定性增加, 关注业绩超预期个股

**分析师: 宋江波**

执业证书编号: S0270516070001

电话: 02160883490

邮箱: songjb@wlzq.com.cn

**研究助理: 胡慧**

电话: 02160883487

邮箱: huhui@wlzq.com.cn

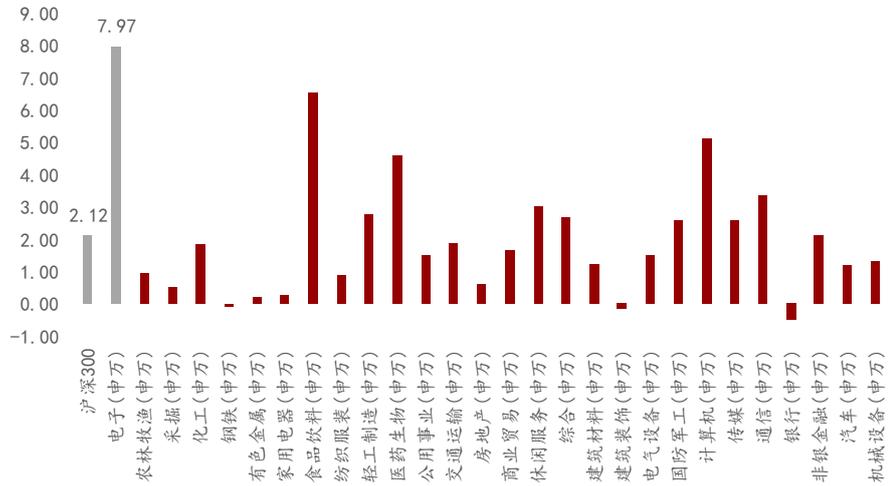
## 目录

1、上周市场行情回顾.....	3
2、本周投资观点.....	5
3、行业动态.....	5
3.1 半导体板块.....	5
3.2 消费电子板块.....	8
4、公司公告.....	10
5、数据跟踪.....	11
图表 1: 申万一级周涨跌幅 (%).....	3
图表 2: 申万一级年涨跌幅 (%).....	3
图表 3: 申万电子各子行业涨跌幅.....	4
图表 4: 申万电子周涨跌幅榜.....	4
图表 5: 全球半导体销售额.....	11
图表 6: 中国集成电路产值.....	12
图表 7: 中国集成电路净进口额.....	12
图表 8: 全球手机出货量.....	12
图表 9: 国内手机出货量.....	12

## 1、上周市场行情回顾

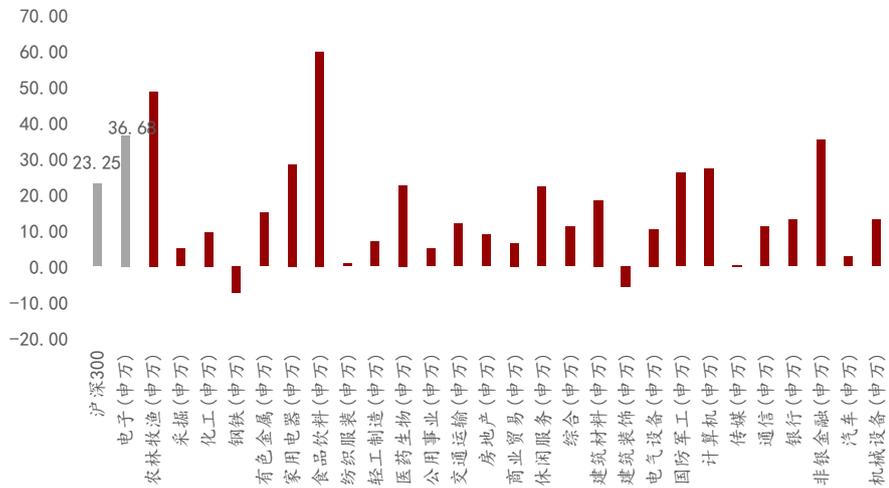
电子指数（申万一级）上周上涨7.97%，在申万28个行业中涨幅排第1，跑赢沪深300指数5.85个百分点。2019年以来上涨36.68%，跑赢沪深300指数13.43个百分点。

图表1：申万一级周涨跌幅（%）



资料来源：wind, 万联证券研究所

图表2：申万一级年涨跌幅（%）



资料来源：wind, 万联证券研究所

从子行业来看，各级子行业全部上涨。二级子行业中涨幅最大的是电子制造（申万），上涨11.14%；涨幅最小的是元件II（申万），上涨5.55%。

三级子行业中涨幅最大的是电子零部件制造（申万），上涨11.51%；涨幅最小的是半导体材料（申万），上涨2.82%。

图表3: 申万电子各子行业涨跌幅

	代码	简称	周涨跌幅 (%)	年涨跌幅 (%)
二级	801081.SI	半导体(申万)	6.97	59.30
	801082.SI	其他电子II(申万)	7.56	21.67
	801083.SI	元件II(申万)	5.55	42.64
	801084.SI	光学光电子(申万)	6.59	21.37
	801085.SI	电子制造II(申万)	11.14	44.66
三级	850811.SI	集成电路(申万)	7.52	61.85
	850812.SI	分立器件(申万)	6.31	30.27
	850813.SI	半导体材料(申万)	2.82	67.86
	850822.SI	印制电路板(申万)	4.64	60.90
	850823.SI	被动元件(申万)	7.19	21.49
	850831.SI	显示器件III(申万)	6.08	33.92
	850832.SI	LED(申万)	6.27	1.86
	850833.SI	光学元件(申万)	10.99	18.42
	850841.SI	其他电子III(申万)	7.56	21.67
	850851.SI	电子系统组装(申万)	10.72	27.27
850852.SI	电子零部件制造(申万)	11.51	60.06	

资料来源: wind, 万联证券研究所

从个股来看, 上周申万电子行业234只个股中上涨209只, 下跌25只。

图表4: 申万电子周涨跌幅榜

电子行业周涨跌幅前五			
证券代码	证券简称	周涨跌幅 (%)	所属申万三级
300657.SZ	弘信电子	34.04	印制电路板
600152.SH	维科技术	32.79	其他电子III
002881.SZ	美格智能	32.33	电子零部件制造
300088.SZ	长信科技	32.13	显示器件III
002600.SZ	领益智造	24.78	电子零部件制造
电子行业周涨跌幅后五			
证券代码	证券简称	周涨跌幅 (%)	所属申万三级
300747.SZ	锐科激光	-6.06	其他电子III
000670.SZ	*ST 盈方	-5.18	集成电路
002547.SZ	春兴精工	-4.66	电子零部件制造
002141.SZ	贤丰控股	-4.66	其他电子III
002952.SZ	亚世光电	-3.68	显示器件III

资料来源: wind, 万联证券研究所

## 2、本周投资观点

上周电子指数上涨7.97%，跑赢沪深300指数5.85个百分点，各级子行业全部上涨。5G牌照发放后，5G终端开始陆续发布，以华为手机、华为鸿蒙系统为代表，国内厂商在5G终端的竞争优势将大大优于4G时期，建议关注5G产业链。半导体方面，全球销售额继续下滑，上半年同比下降14.5%，其中6月份同比下降16.8%，降幅较大，继续关注反转信号，建议关注细分板块龙头的国产替代机会。另外，现在已进入业绩预告公告期，建议关注业绩超预期个股。

### 7月国内手机同比下降7.5%，5G手机人气旺

根据中国信通院数据，2019年7月我国国内手机市场总体出货量3419.9万部，同比下降7.5%。2019年1-7月，国内手机市场总体出货量2.20亿部，同比下降5.5%。整体手机销售仍处于下滑周期，但是5G手机销售火热。华为Mate 20X 5G版预约量全平台突破百万台，8月16日开始销售，销售首日在天猫仅1秒即被一抢而空，可见5G手机市场需求旺盛，随着更多5G机型上市及价格下滑，预计手机销量有望止跌回升。

### 2019Q2全球手机市场中国品牌市占率42%

根据IHS Markit的数据，2019年第二季度中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，展现出强劲竞争力。其中华为手机全球市占率18%，排名第二；OPPO手机销量3620万部，超过苹果全球排名第三。中国手机全球竞争力逐渐加强，我们认为国内厂商在5G终端的竞争优势将大大优于4G时期，建议关注华为5G产业链。

## 3、行业动态

### 3.1 半导体板块

#### 1. IC Insights: MCU市场将触底反弹

根据研调机构《IC Insights》最新调查报告显示，由于美中贸易战导致电子科技市场成长放缓，全球汽车销售额下滑，今年半导体微控制器(MCU)市场预计将萎缩6%，不过预计经历今年惨澹的衰退后，MCU市场将回弹。

由于受惠于智慧型IC芯片卡市场急速回弹，日益改善的全球经济，加上物联网(IoT)、可穿戴式装置等需求，MCU市场在过去两年创下破纪录的销售业绩。但受到了美中两大经济体的贸易紧张情势影响，今年上半年MCU销售额年减13%，而MCU单位出货量则下降了14%。

而来到2019年中期，MCU市场渐趋稳定，IC Insights预估微控制器将在未来半年内跌幅脱离两位数百分点，并在今年结束时下降5.8%至165亿美元，略逊于2018年年底结束时的新高位176亿美元。

数据显示，预计2019年全球MCU单位出货量，将从2018年的281亿下降至269亿。估计到2020年，MCU市场在经历过2019年的动荡衰退后，出现适度的反弹回归，市场展望明年将增长3.2%至171亿美元，预期出货量将成长超过7%，可望创下289亿单位的新纪录高业绩，甚至超越2018年的年度峰值281亿。

IC Insights的MCU市场中更新展望，预测2018至2023年的微控制器销售额复合年均增长率(CAGR)增长3.9%，并在2023年达到213亿美元。估计MCU单位出货量在五年内复合年均增长率达到6.3%，至2023年可望达到382亿。

全球MCU市场，在近几年受到强劲的汽车产业发展激励，自动驾驶感测器所需的单芯片，和连接物联网(IoT)的需求，不过营收也受到了逐年递减的ASP(动态伺服器网页)销售影响，主要是因为32位元的MCU产品激烈竞争所致。

IC Insights 认为，32 位元的MCU 的平均售价已经结束下滑，2018 年至2023 年的平均销售价格，估计将下跌CAGR 3.7%，而2013 至2018 年期间的CAGR 则下跌16.1%。

汽车应用仍然是MCU 最大的终端用户市场，占2019 年微控制器总销售额的39% 左右。

据IC Insights 估计，目前约有9% 的汽车MCU 销售来自物联网中用于连接车辆的微型控制器。

于汽车产业里的MCU 的销售额，预计将在2019年下滑5%至64亿美元，此前2018年汽车销量开始下滑时，MCU仅上涨1.1%。

目前汽车最新MCU销售额，估计将在2020年上升1%，并接近65亿美元，随后在2021到2023期间涨幅将逐步增强，最终预测年度将达到81亿美元。

新闻来源：半导体行业观察

## 2. 全球闪存厂最新营收排名出炉

根据集邦咨询半导体研究中心 (DRAMeXchange) 调查，综观2019年第二季NAND Flash (闪存) 产业营收表现，以需求面来看，智能手机、笔记本电脑以及服务器需求皆自第一季的传统淡季有所复苏，整体产业位元消耗量成长约15%，但由于供应商仍握有相当高的库存，致使第二季合约价跌幅仍相当显著，整体产业营收仍维持在约108亿美元的水平，较第一季基本持平。

展望2019年第三季，虽然预期旺季需求有助于出货表现，但受地缘经济冲突影响，恐导致需求表现较往年疲弱，但NAND Flash供给面受到东芝六月跳电事件冲击影响甚巨，使得第三季合约价跌幅明显收敛，而Wafer市场则呈现涨势，预估整体营收较第二季增长的可能性较高。

新闻来源：全球半导体观察

## 3. SK海力士新产品规划：2030年推800+层堆叠闪存

目前，两大韩系NAND Flash厂商——三星及SK海力士已经公布了新NAND Flash产品的发展规划。其中，三星宣布推出136层堆叠的第6代V-NAND Flash，SK海力士则是宣布成功开发出128层堆叠的4D NAND Flash，并已经进入量产阶段。

不过，虽然两家厂商竞相推出NAND Flash的新产品，但是堆叠技术的发展至今仍未到达极限。所以，SK海力士日前在一场会议上就公布了公司的规划，预计在2030年推出800+层的NAND Flash，届时将可轻松打造出100到200TB容量的SSD。

在日前举行的“Flash Memory Summit”大会上，SK海力士公布旗下新产品的规划以及公司的相关布局。根据内容指出，目前SK海力士正在开发128层堆叠的4D NAND Flash，其量产时间将落在2019年第4季。

另外，SK海力士还展示了一款“PE8030”的全新SSD，采用PCIe 4.0×4介面连接，提供了800GB、1600GB、3200GB、6400GB容量，连续读写速度最高可达6200MB/s、3300MB/s，而4KB随机读写最高可达950K IOPS、260K IOPS。

在研发发展方面，目前SK海力士正在研发176层NAND Flash，而其他产品的发展，包括72层堆叠的4D NAND Flash目前在大规模量产中，96层堆叠的4D NAND Flash目前也在大规模量产中，而且未来产能即将超越72层堆叠的4D NAND Flash。

128层堆叠的4D NAND Flash将于2019年第4季量产，176层堆叠产品2020年问世、500层堆叠产品则将于2025年问世，其TB/wafer容量比将可提升30%。而800+堆叠的4D NAND Flash则是预计2030年问世，TB/wafer容量比提升到100到200TB的大小。

据了解，目前SK海力士生产的128层堆叠NAND Flash核心容量是1Tbit，176层堆叠的

核心容量则是来到1.38Tbit，预计500层堆叠时核心容量可达3.9Tbit，到800层堆叠时则会高达6.25Tbit，是现在的6倍多。

若以当前SSD固态硬盘的容量计算，目前最大容量约在15到16TB左右。而依照6倍核心容量的成长幅度来计算，未来SSD容量可达200TB左右，这个容量要比当前的HDD还要更大。

新闻来源：全球半导体观察

#### 4. 镁光开始量产第三代10nm制程存储

美光周四宣布，该公司一开始量产基于第三代 10nm 制程（又称 1z nm）制程的存储芯片，首批到来的便是 16Gb DDR4 / LPDDR4 DRAM 器件。随着时间的推移，该公司还将进一步扩大其产品组合。与第二代 10nm 工艺相比，新工艺使得美光能够提升 DRAM 芯片密度，在增强性能的同时、降低产品的功耗。

值得一提的是，第三代 10 nm 制程的 16Gb DDR4 器件功耗，较同频的两个 8Gb DDR4 DRAM 还要低 40%。

至于 16 Gb LPDDR4X IC，美光称其更是提升了 10% 的能效。由于第三代 1Z nm 工艺较第二代 1Y nm 的比特密度更高，该公司可产出性价比更高的存储芯片。

鉴于美光未透露 16 Gb DDR4 DRAM 的速度分档，我们只能预计其符合 JEDEC 的官方指定范围内。

预计首批 16 Gb DDR4 DRAM 产品将用于台式机、笔记本、工作站上的大容量（32GB 或更高）内存模组。

移动存储器方面，美光 16 Gb LPDDR4X 芯片的传输速率可达 4266 MT/s。

除了为高端智能机提供高达 16 GB（8x16Gb）的 LPDDR4X DRAM 封装，美光还将提供基于 UFS 的多芯片封装（uMCP4），将 NAND 用于存储和 DRAM。

该公司针对主流手机的 uMCP4 系列产品，将包括 3GB RAM + 64GB ROM 至 8GB RAM + 256GB ROM 等产品。

最后，美光没有透露其生产 1Z nm 制程 16 Gb DDR4 / LPDDR4X 芯片的工厂。不出意外的话，应该会在日本广岛工厂内生产。

与此同时，分析师猜测该公司会在台中附近的 Micron Memory Taiwan（前 Rexchip Semiconductor）晶圆厂启用 1Z nm 制程生产线。

新闻来源：半导体行业观察

#### 5. 阿里平头哥正在研发专用SoC芯片

据消息人士透露，阿里平头哥正在研发一款专用SoC芯片，该SoC芯片将用于新一代阿里云神龙服务器的核心组件MOC卡，以推动下一代云计算技术的升级。

阿里巴巴于2018年9月的云栖大会上宣布，成立一家芯片自研开发的全资子公司，取名“平头哥半导体有限公司”，构建以AI iNPU智能芯片和嵌入式芯片为核心的芯片战略。“平头哥”为阿里此前收购的中天微系统有限公司和达摩院自研芯片业务整合而成。

在去年成立之初，平头哥表示，公司初期研发的芯片主要包括以下3个方面：

人工智能芯片

基于城市大脑、无人驾驶、智能家居、新零售等业务需要，研发AI芯片，重点打造芯片在推进效能的情况下兼顾功耗以及可编程性，达到最优平衡。规划研发三代 AI iNPU，V1是针对视频图像处理的云+端AI推理芯片，V2是云上AI的训练/推理通用芯片，V3是针对端上推理应用的定制化AI芯片以满足嵌入式需求。

嵌入式芯片

基于大陆唯一自主嵌入式CPU IP Core(阿里全资收购的中天微公司技术), 研发边缘芯片架构及配套的基础软件, 提供全面的芯片架构, 具备原型芯片的输出能力, 灵活定制满足个性化需求的IoT芯片, 打造物联网的基础设施。联合产业链合作伙伴, 共同打造面向智能汽车、智能监控、智能家电、智能电网和智能工业等领域的芯片生态。

#### 量子芯片

此外除了 AI 芯片, 量子计算也是达摩院的重要研究方向之一。今年 5 月, “太章”成为了全球首个 81 比特随机量子电路模拟器。

2018年5月, 阿里云自研的弹性计算技术架构“神龙(X-Dragon)”首次全方位曝光, 这种新型的计算架构打破了过去物理机和虚拟机的隔阂, 既保留了物理机的性能优势和硬件级隔离, 又具备虚拟机的弹性资源、分钟级交付、全自动运维的优势。

据悉, 通过底层技术创新, 阿里云研发团队自研了“X-Dragon虚拟化芯片”, “X-Dragon Hypervisor 系统软件”, 以及“X-Dragon服务器硬件架构”, 这三部分组成了今天的神龙架构。其中X-Dragon虚拟化芯片在芯片层解决了虚拟机和物理机体系结果不一致的问题, 让二者能够在系统软件层面保持100%兼容。

此外, 传统的Hypervisor (Xen, KVM等)完全是通过软件的形式实现的, 神龙的一大创新在于融合了系统软件和芯片的能力, 不仅仅是可以支持X86架构的芯片, 还可以支持ARM, Power以及国产CPU等架构。这种优势让神龙架构可以无缝联入传统的云基础设施, 保持产品和使用体验的一致。

目前, 基于神龙架构的弹性裸金属服务器已正式商业化售卖, 支持8核、16核、32核、96核等多个CPU规格, 并支持3.7 GHz ~ 4.1 GHz的超高主频实例。

此次, 传出平头哥正在研发一款专用SoC芯片的消息, 说明将会有更多的云产品采用神龙技术架构。这也是阿里“人工智能芯片”AI iNPU发展战略其中的一个阶段。

而在发展“嵌入式芯片”方面, 今年7月25日, 平头哥发布了其首款处理器玄铁910 (XuanTie910)。玄铁910基于RISC-V开源架构开发, 核心针对高性能计算, 是一款IP core。该芯片单位性能7.1 Coremark/MHz, 主频在12nm工艺下达到了2.5GHz。面向AIoT、更丰富的万物互联场景, 性能更高, 适用性更广, 开发和进一步流片量产的门槛更低。

新闻来源: 半导体行业观察

### 3.2 消费电子板块

#### 1. 7月国内手机市场整体出货量3419.9万部, 同比下降 7.5%。

国内手机市场总体出货量。2019年7月, 国内手机市场总体出货量 3419.9万部, 同比下降 7.5%, 其中, 4G 手机 3291.7 万部, 同比下降 4.5%; 2019年 1-7 月, 国内手机市场总体出货量 2.20 亿部, 同比下降 5.5%, 其中 4G 手机 2.11 亿部, 同比下降 4.3%。

国内手机市场上市新机型数量。2019年7月, 上市新机型 52 款, 同比下降 43.5%, 含 2G 手机 16 款、4G 手机 32 款、5G 手机 4 款; 2019年 1-7 月, 上市新机型 298 款, 同比下降 39.1%, 含 2G 手机 63 款、3G 手机 1 款, 4G 手机 229 款、5G 手机 5 款。

新闻来源: 中国信通院

#### 2. 华为5G折叠屏手机MateX重新入网国内将上市: 售价或万元起

之所以重新拿到了入网证, 主要是它的设计上进行了调整。在外形上调整的细

节是：额外添加了第四枚摄像头。产业链透露，由于进行了外形上调整，Mate X的产能将会更受限制，预计首批供货不会超过10万台。

8月18日消息，工信部最新公布的细节显示，华为Mate X已经重新拿到了入网许可证，这也为它上市开卖做好了铺垫，而之所以重新拿到了入网证，主要是它的设计上进行了调整。

从工信部上显示的图片看，型号为TAH-AN00的Mate X，在外形上调整的细节是：额外添加了第四枚摄像头，这是一枚ToF镜头，用于测量红外光束从拍摄对象返回手机所需时间的传感器将能够极大改善后置摄像头的拍摄效果。

此外，Mate X的后置身摄像头组件及中间铰链区域由碳纤维材料覆盖，而手机主屏幕展开之后也更为平整一些。为了不会出现类似三星折叠屏的事情，Mate X可以做到20万次折叠不变形，其配备的转轴采取了四层结构设计，最上面一层是高分子材料的屏幕保护层，第二层是可弯曲的柔性屏幕，第三层是软胶支撑片，最下面一层才是转轴，这样确保了转轴和屏幕能够稳定正常的工作。

新闻来源：集微网

### 3. 据市场分析 2024年折叠屏手机出货量将达到5000万

8月15日消息，基于相关市场分析，IHS Markit指出，折叠屏手机的出货量将在2024年达到5000万。另外，2019年上半年智能手机出货量同比有所下降，但AMOLED屏幕的出货量不降反增，在今年二季度有望增长30%。

其实，目前阻碍折叠屏手机发展的因素是高昂的成本、多次折叠后屏幕的耐用性和低良品率。不过，这些问题只是暂时的。相信随着AMOLED价格的下降和相关技术的发展，良品率会相应提升，成本也会快速下降，届时将有更多手机厂商加入折叠屏手机的阵营，加快市场普及。可以发现，今年上半年LTPO、屏下摄像头、3.5D盖板玻璃等技术受到了广泛关注。

目前市场上正式在销售的折叠屏手机是“FlexPai柔派”，这也是全球第一款折叠屏手机，它于去年10月份发布，这款手机厚度仅7.6毫米，屏幕采用7.8英寸柔宇蝉翼柔性屏二代，采用外折方案。据了解，“FlexPai柔派”来自柔宇科技公司，这是一家致力于柔性显示、柔性传感、柔性屏手机及相关智能设备的公司。

此外，另外两款备受关注的折叠屏手机是三星Galaxy Fold和华为Mate X。三星Galaxy Fold发布于今年2月份，屏幕为7.3英寸，采用内折方案；但三星这款手机还未真正上市就出现屏幕隆起、闪屏、黑屏等问题，因此目前还处于预售状态。

而华为的折叠屏手机Mate X也在今年2月份发布，原本定于6月底开卖，但因为种种原因而延期。前不久，华为在2019开发者大会上发布了业界首份《折叠屏UX设计规范》，这一规范将引领折叠屏应用迈入新阶段，也有望稳步推进折叠屏手机的发展。因此，折叠屏手机很有可能是智能手机的未来，而在2024年出货量达到5000万也不是不可能。

新闻来源：集微网

### 4. Apple Watch 5将采用JDI OLED屏

Apple Watch是苹果最成功也几乎是全球最卖座的可穿戴单品，发布之初被吐槽的方形表盘渐渐被多数用户接受，甚至成为潮流美学代名词。

多方消息爆料苹果秋季新品发布会定在9月10日，除了“iPhone 11”系列，Apple Watch 5同样饱受关注。

根据分析师郭明錤的最新报告，Apple Watch 5将延续OLED显示屏，JDI有望作为供应商。另外，AW5会提供钛合金和陶瓷表壳型号供选择。前面的四代，苹果从未用过

钛合金，2代和3代倒是用过陶瓷，可4代又缺席了。

值得一提的是，对于未来苹果产品线的OLED面板，郭明璜认为LG会更多参与，同时，中国BOE（京东方）也会加入进来。

此前，郭大神预测，2020年，苹果将率先应用MicroLED显示技术，相较于OLED，它更加省电，同时不易烧屏。

去年的AW4提供40mm和44mm表径款式，运行速度更快，新增跌落检测、数字心电图功能，续航时间为两天。

新闻来源：集微网

## 4、公司公告

### 1. 大族激光：2019年半年度报告

公司发布了2019年半年度报告，上半年公司实现营业收入47.34亿元，同比减少7.30%；实现归母净利润3.79亿元，同比减少62.74%；实现扣非归母净利润3.36亿元，同比减少57.17%。

### 2. 兆易创新：持股5%以上股东减持股份计划公告

大股东持股的基本情况：截止本公告披露日，朱一明先生持有北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票38,541,160股，约占公司总股本的12.02%；香港赢富得有限公司持有公司股票29,286,600股，约占公司总股本的9.14%。

减持计划的主要内容：朱一明先生和香港赢富得有限公司拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份，减持期间为：集中竞价方式自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，大宗交易方式自本公告披露日起8个交易日后的6个月内。朱一明先生拟减持公司股份不超过640万股，不超过公司总股本的2%；香港赢富得有限公司拟减持公司股份不超过1,282万股，不超过公司总股本的4%。若公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。

### 3. 圣邦股份：2019年半年度报告

公司发布了2019年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.96亿元，同比增长3.99%；实现归母净利润0.60亿元，同比增长47.19%；实现扣非归母净利润0.58亿元，同比增长50.11%。

### 4. 汇顶科技：关于对外投资设立孙公司并购买资产的公告

交易简要内容：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“汇顶科技”）拟通过现金支付的方式购买NXP B.V.（以下简称“恩智浦”）旗下的语音及音频应用解决方案业务（Voice and Audio Solutions，以下简称“VAS”），交易价格为16,500万美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及签约到交割前被转让债务及净库存调整额及其他费用，该等费用将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担）。交易模式为汇顶科技通过汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）在恩智浦VAS业务所在的部分国家设立孙公司，与汇顶科技及其现有子公司一起承接VAS业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员（以上购买资产及为完成资产购买设立孙公司事项统称为“本次交易”）。

以客户需求为导向及全球布局一直是汇顶发展的重要策略，公司创新及发展的根本

来源于客户和市场的需求。本次交易会同时给公司的营收、产品带来新的成长契机，符合公司在智能移动终端产品发展的规划方向，同时将现有产品与新产品进行整合，为公司在新的产品领域进一步发力、持续为客户提供有价值的产品打好基础。

本次交易涉及的专属知识产权包括专利权、特许权、非专利技术、商业秘密等，会依据《企业会计准则第6号——无形资产》进行相应的会计确认。目前，公司已委托专业评估机构就VAS业务的资产包提供收购价格分配相关服务，公司将通过此次交易取得的可辨认无形资产的公允价值进行确认及摊销。本次交易完成后，VAS业务将被纳入公司合并报表范围，无形资产的摊销金额将计入当期损益，同时公司资产总额、营业收入、利润总额等财务指标预计将会增加。

在承接目标业务资产包中的知识产权后，汇顶科技将通过签订知识产权转让及许可协议授权恩智浦指定子公司在手机以外的其他产品范围中使用目标资产包中的知识产权，此授权对我司影响甚微。

### 5. 水晶光电：关于台风“利奇马”对公司影响情况的公告

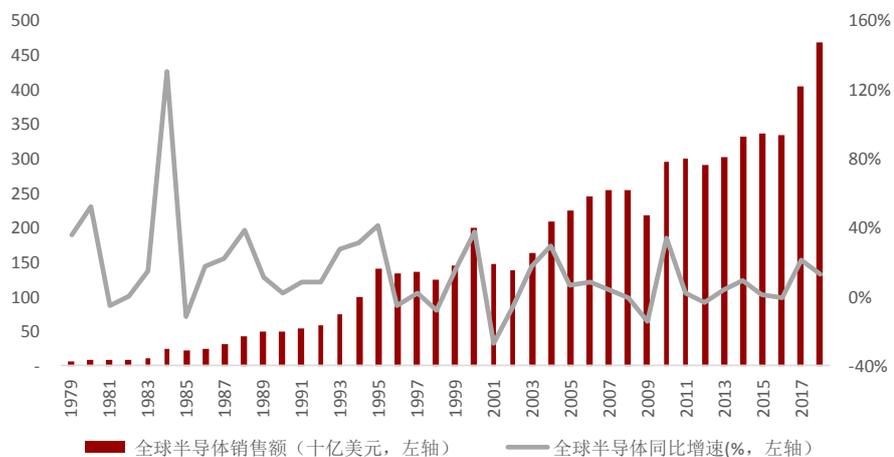
2019年8月10日凌晨1点45分前后，今年第9号超强台风“利奇马”在浙江台州温岭沿海登陆，登陆时中心附近最大风力16级，成为建国以来登陆浙江的第三强台风，也是建国以来登陆台州的最强台风。浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部分下属子公司位于浙江省台州市，现就本次台风对公司的影响情况公告如下：

经初步估计，本次台风造成公司直接经济损失约合人民币1,200万元。上述绝大部分资产均已投保，公司正积极与有关保险公司办理核损理赔手续。

由于公司针对此次台风灾害事先采取了有力的防范措施，本次台风不会对公司正常的生产经营产生重大影响，预计对公司2019年度经营业绩影响较小。公司已积极采取减损措施，确保将损失降到最小程度，敬请广大投资者注意投资风险。

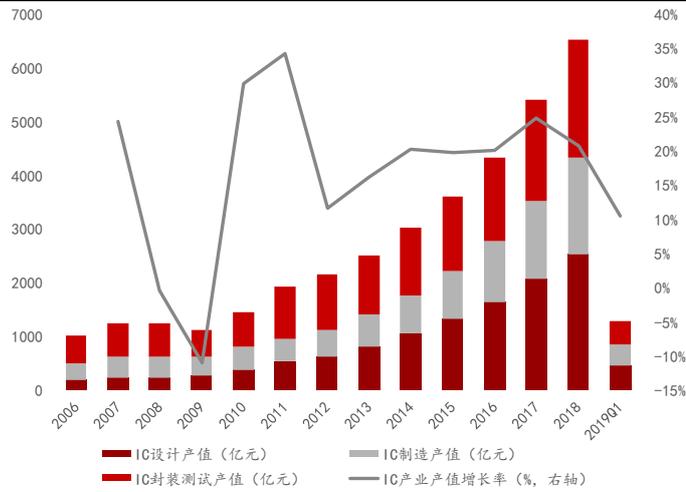
## 5、数据跟踪

图表5：全球半导体销售额



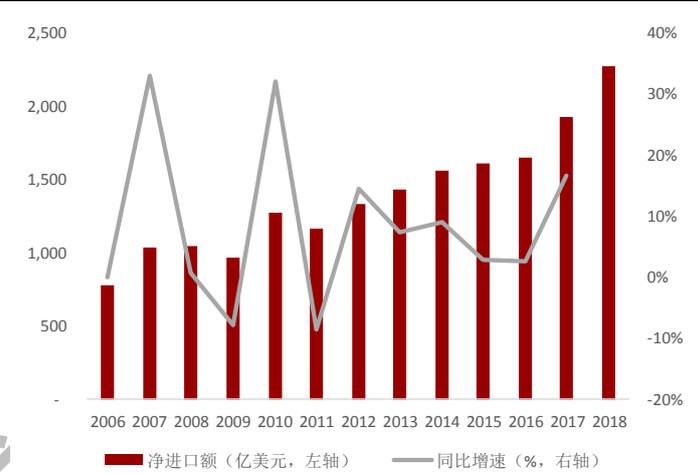
资料来源：SIA，万联证券研究所

图表6: 中国集成电路产值



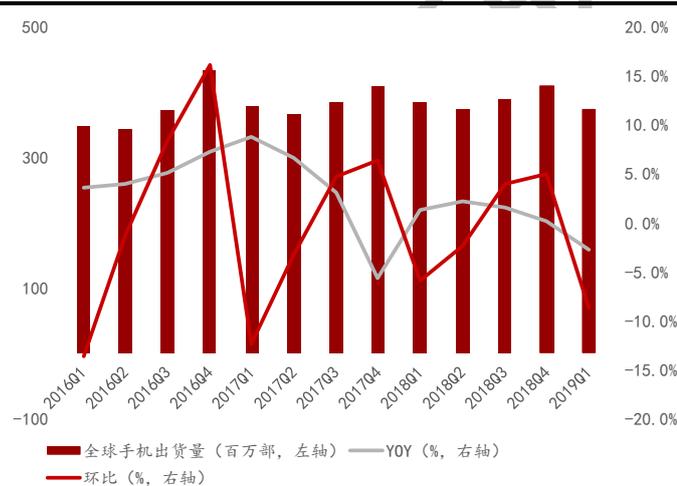
资料来源: CSIA, 万联证券研究所

图表7: 中国集成电路净进口额



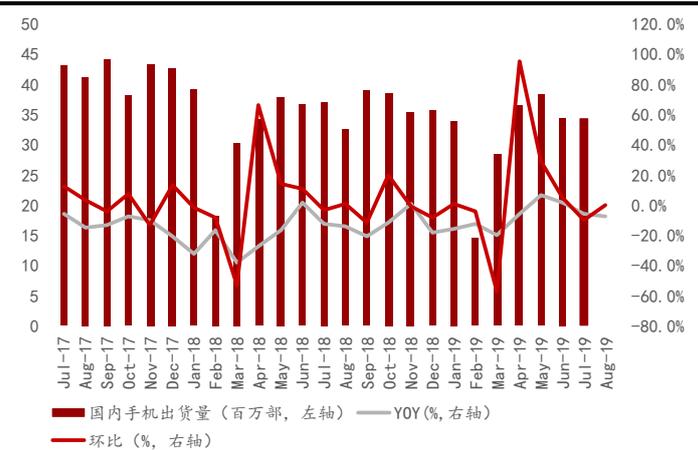
资料来源: CSIA, 万联证券研究所

图表8: 全球手机出货量



资料来源: Gartner, 万联证券研究所

图表9: 国内手机出货量



资料来源: 中国信通院, 万联证券研究所

风险提示: 行业景气度不及预期的风险; 国内外政策变动风险

## 行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

## 公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

## 风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 免责声明

本报告仅供万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本公司是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，本公司不对本报告所涉及的任何法律问题做任何保证。本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。研究员任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。

未经我方许可而引用、刊发或转载的，引起法律后果和造成我公司经济损失的，概由对方承担，我公司保留追究的权利。

## 万联证券股份有限公司 研究所

上海 浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心

深圳 福田区深南大道2007号金地中心

广州 天河区珠江东路11号高德置地广场